

特点：

- 低插入损耗：典型插入损耗 0.4dB
- 优异的输入输出匹配：驻波比典型值 1.5:1
- 高承受功率：脉冲承受功率 400W
- SMT 封装
- 封装尺寸：8.1*5.1*3.0mm³(不含引脚)
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数 (25℃)：

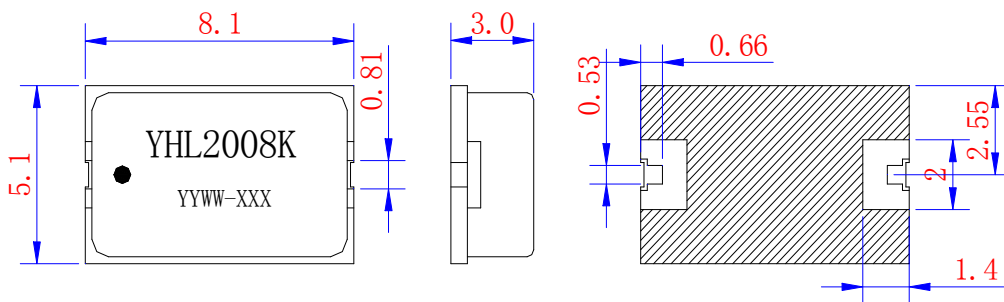
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$	960		1250	MHz	全温
插入损耗	IL	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$ $f=960\sim1250\text{MHz}$		0.6	0.8	dB	全温
输入驻波比	VSWR _i			1.5:1	2.0:1		全温
输出驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
脉冲波承受功率	P _{PULSE}	Pulse width≤25μs; Duty cycle≤2.5%			400	W	
限幅电平	P _O	P _{PULSE} =400W		17	21	dBm	
工作温度	T		-40		+70	℃	
质量	m				2	g	

极限参数表：

参数名称	极限值	单位
输入功率	450	W
储存温度	-45~+85	℃

封装外形图：

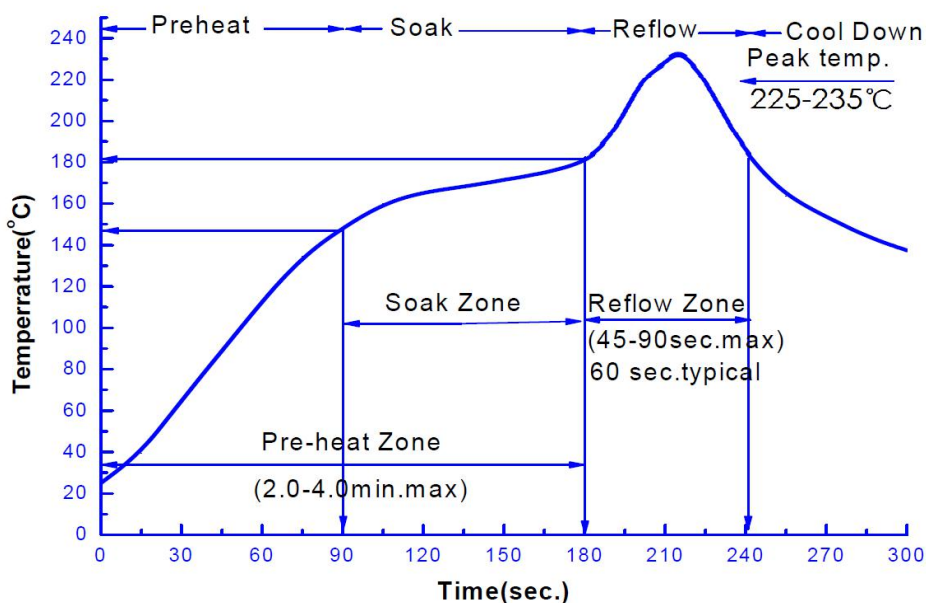
单位：mm 公差：±0.2mm


字符标志及引脚定义：

字符	定义
YHL2008K	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号
●	射频输入端
///	接地

产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
3. 对于采用 PCB+屏蔽罩组合封装的产品，如拆包后未使用完，需及时进行密封处理，如有包装有漏封，产品使用前建议按照 125℃，时间 4 小时进行烘烤，避免 PCB 因吸潮而导致 SMT 时 PCB 内部分层。
4. 产品焊接时请保证良好的接地（GND 引脚和底部金属化区域均需进行焊接），保证射频信号接地的同时，也保证产品机械固定的可靠性。
5. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

6. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
7. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
8. 印制板和屏蔽罩组合式的产品属于非密封器件，客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，保证产品上的缝隙及输入/输出孔口完全被覆盖，以提高产品耐环境适应性能力。
9. 其他产品使用注意事项参考各《产品使用注意事项》相关要求。